



Hauptmerkmale

| | |
|------------------------------|----------------|
| Baureihe | Modicon M580 |
| Produkt- oder Komponententyp | Prozessormodul |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------|--------------------|
| Stromaufnahme | 295 mA bei 24 V DC |
| MTBF Zuverlässigkeit | 946000 H |
| Beschriftung | CE |

Montage

| | |
|----------------------------------|---|
| Vibrationsfestigkeit | 3 gn |
| Stoßfestigkeit | 15 gn |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25...60 °C |
| Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40...85 °C |
| Betriebshöhe | 0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 5...95 % bei 55 °C ohne Kondensation |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Richtlinien | 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit 2006/42/EC - Maschinenrichtlinie 2014/34/EU - ATEX-Richtlinie |
| Produktzertifizierungen | CE[RETURN]UL[RETURN]CSA[RETURN]RCM[RETURN]EAC[RETURN]Handelsmerkmal[RETURN]TUV Zone 2/22[RETURN]IECEx Zone 2/22[RETURN]TUV |
| Normen | EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, Interface Typ 1 und Type 2 EN/IEC 61850-3, Standort G EN/IEC 60079-0 |
| Umgebungseigenschaften | Gefahrenbereich Klasse I Division 2 Gasbeständig Klasse Gx entspricht ISA S71.04 Gasbeständig Klasse 3C4 entspricht IEC 60721-3-3 Staubbeständig Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Sandbeständigkeit Klasse 3S4 entspricht IEC 60721-3-3 Salzbeständig Level 2 entspricht IEC 68252 Spritzgussbeständigkeit Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 Pilzsporen-resistent Klasse 3B2 entspricht IEC 60721-3-3 |
| Beschichtung | Schutzlack |
| Sicherheitsniveau | SIL 3 PL = e |
| Versorgung | Interne Stromversorgung über Modulträger |

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgelegt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung durchzuführen, sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

| | |
|-------------------|---|
| LED-Statusanzeige | 1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (grün) Prozessor im Sicherheitsmodus (SRUN) 1 LED (grün) Prozessor im Wartungsmodus (SMOD) |
| Produktgewicht | 0,849 kg |

Verpackungseinheiten

| | |
|---------------|----------|
| VPE 1 Art | PCE |
| VPE 1 Menge | 1 |
| VPE 1 Höhe | 9,0 cm |
| VPE 1 Breite | 18,9 cm |
| VPE 1 Länge | 25,2 cm |
| VPE 1 Gewicht | 830,0 g |
| VPE 2 Art | S03 |
| VPE 2 Menge | 6 |
| VPE 2 Höhe | 30,0 cm |
| VPE 2 Breite | 30,0 cm |
| VPE 2 Länge | 40,0 cm |
| VPE 2 Gewicht | 5,452 kg |

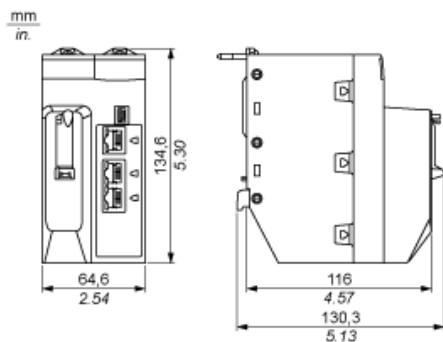
Nachhaltigkeit

| | |
|-------------------------------------|---|
| Angebotsstatus nachhaltiges Produkt | Green Premium Produkt |
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) |
| Quecksilberfrei | Ja |
| RoHS-Richtlinie für China | RoHS-Erklärung Für China |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |
| Umweltproduktdeklaration | Produktumweltprofil |
| Kreislaufwirtschafts-Profil | Entsorgungsinformationen |
| WEEE | Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen. |

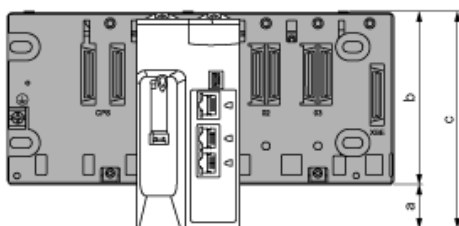
Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

Nur CPU-Module

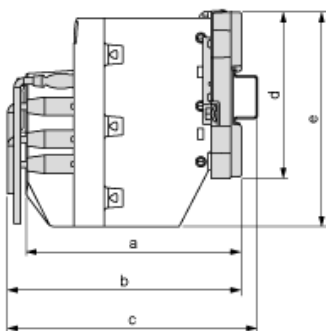


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.) Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.)
- c: Die Höhe des lokalen Haupttracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schientiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)